

Actualización de información de PowerEdge R7515: hoja técnica

Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Visión general	4
Historial de revisión.....	4
Capítulo 2: Actualización de información	5
Especificaciones de PSU.....	5
Pautas para la instalación de tarjetas de expansión.....	5

Visión general

La información de este documento reemplaza la información en las secciones pertinentes del Manual de instalación y servicio, la Guía de referencia de BIOS y UEFI, y las Especificaciones técnicas.

Para obtener la información completa, consulte los documentos disponibles en <https://www.dell.com/poweredgemanuals>.

Temas:

- [Historial de revisión](#)

Historial de revisión

En esta sección, se proporciona una descripción de los cambios del documento.

Tabla 1. Historial de revisión del documento

Revisión del documento	Fecha	Descripción de cambios
1	Noviembre de 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Pautas para la instalación de tarjetas de expansión2. PSU actualizada

Actualización de información

Temas:

- Especificaciones de PSU
- Pautas para la instalación de tarjetas de expansión

Especificaciones de PSU

El sistema PowerEdge R7515 es compatible con las siguientes fuentes de alimentación (PSU) de CC o de CA:

Tabla 2. Especificaciones de PSU

PSU	Clase	Disipación de calor (máxima)	Frecuencia	Voltaje
CA de 1600 W	Platinum	6000 BTU/h	50/60 Hz	De 100 a 240 V de CA
CA de 1600 W	Titanium	5840 BUT/h	50/60 Hz	200-240 V CA
CC de 1100 W	NA	4416 BTU/h	NA	-48 — -60 V de CC
1100 W CA	Platinum	4100 BTU/h	50/60 Hz	De 100 a 240 V de CA
HVDC de 1100 W	Platinum	4100 BTU/h	50/60 Hz	De 100 a 240 V de CA
	NA	4100 BTU/h	NA	De 200 a 380 V de CC
750 W de CA	Platinum	2891 BTU/h	50/60 Hz	100—240 V de CA, autoajustable
HVDC de 750 W	Platinum	2891 BTU/h	50/60 Hz	100—240 V de CA, autoajustable
	Platinum	2891 BTU/h	NA	240 V CC
750 W de CA	Titanium	2843 BTU/h	50/60 Hz	De 200 a 240 V de CA
CA de 495 W	Platinum	1908 BTU/h	50/60 Hz	100—240 V de CA, autoajustable

- NOTA:** Cuando seleccione o actualice la configuración del sistema, para garantizar un consumo de energía óptimo, verifique el consumo de energía del sistema con Dell Energy Smart Solution Advisor, disponible en [Dell.com/ESSA](https://www.dell.com/ESSA).
- NOTA:** La disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios del sistema de alimentación.
- NOTA:** Este sistema ha sido diseñado también para la conexión a sistemas de alimentación de TI con un voltaje entre fases no superior a 230 V.
- NOTA:** Si un sistema con una PSU de 1600 W de CA funciona a línea baja, 100-120 V de CA, la potencia por PSU se reduce a 800 W.
- NOTA:** Si un sistema con una PSU de 1100 W de CA o una PSU de 1100 W de modo mixto funciona a línea baja, 100-120 V de CA, la potencia por PSU se reduce a 1050 W.

Pautas para la instalación de tarjetas de expansión

La siguiente tabla describe las tarjetas de expansión compatibles:

Tabla 3. Configuraciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión

Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión	Ranuras PCIe de la tarjeta elevadora	Conexión del procesador	Altura	Longitud	Anchura de la ranura
Tarjeta elevadora: 1B (tarjeta elevadora de 2U)	Ranura 2	Procesador 1	Altura completa	Longitud completa	x16
Tarjeta elevadora: 1B (tarjeta elevadora de 2U)	Ranura 3	Procesador 1	Altura completa	Longitud completa	x16
Tarjeta elevadora: 1A (tarjeta elevadora de perfil bajo, a la derecha)	Ranura 2	Procesador 1	Perfil bajo	Longitud media	x16
Tarjeta elevadora: 2 (tarjeta elevadora de perfil bajo, a la izquierda)	Ranura 3	Procesador 1	Perfil bajo	Longitud media	x16

NOTA: Las ranuras de la tarjeta de expansión no son intercambiables en caliente.

La siguiente tabla proporciona las pautas de instalación de las tarjetas de expansión para asegurar una refrigeración adecuada y un buen encaje mecánico. Las tarjetas de expansión con la prioridad más alta se deben instalar primero utilizando la prioridad de ranura indicada. Las demás tarjetas de expansión se deben instalar en orden de prioridad de tarjeta y de ranura.

Tabla 4. Configuraciones de tarjeta elevadora: sin tarjeta elevadora; CPU

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Tarjeta elevadora LOM; 2x1G BCM5720L (FXN)	1	1
Tarjeta elevadora LOM; 2x10G BCM57416 (BASeT/SFP+, FXN)	1	1
Tarjeta elevadora de LOM; 2x25G (Broadcom)	1	1
GPU: Nvidia A2 16GB (LP)	5	1
GPU: nVIDIA T4 de 16 GB	5, 4	2
SSD PCIe NVMe	5, 4	2
Mellanox 100G (CX5/CX6 H100)	4, 5	2
Mellanox 25G (CX4LX DP/CX5 DP)	5, 4	2
Emulex (FC32 SP/DP)	4, 5	2
Emulex (FC16 SP/DP)	5, 4	2
Emulex (HBA FC32 1P S28)	5, 4	2
Qlogic (HBA FC32 SP/DP)	4, 5	2
Qlogic (HBA FC16 SP/DP)	5, 4	2
Qlogic 10G (SFP DP)	5, 4	2
Qlogic 25G (BaseT DP)	5, 4	2
Qlogic (HBA FC32 1P S28)	4, 5	2
Solarflare 25G (SFP DP)	5, 4	2
Intel 10G (BaseT DP)	5, 4	2
Intel 10G (SFP+ DP)	5, 4	2

Tabla 4. Configuraciones de tarjeta elevadora: sin tarjeta elevadora; CPU (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Intel 1G (QP)	5, 4	2
Intel 25G SFP DP	5, 4	2
Intel 25G LP 2P S28	5, 4	2
Broadcom 1G (QP)	5, 4	2
Broadcom 10G (BaseT DP)	5, 4	2
Broadcom 25G (SFP DP)	5, 4	2
PERC 10: adaptador externo (Dell)	4, 5	1
HBA: adaptador externo (Dell)	4, 5	1
Almacenamiento interno (BOSS)	5, 4	1
PERC 9: Mini mono (H730P/H330)	Ranura integrada	1
PERC 10: Mini mono (H740P)	Ranura integrada	1
HBA: Mini mono (HBA330)	Ranura integrada	1
PERC 10: adaptador externo (H840)	5, 4	2
PERC 10: adaptador externo (H840) (FH o LP)	5, 4	2
PERC 11: adaptador externo (HBA355E)	5, 4	2
HBA: adaptador externo	5, 4	2
Tarjeta elevadora de LOM (2x1G)/(2x10G)/(2x25G)	1	1
Intel, NIC: 100Gb, CRD,NTWK,INTL,LP,100G,2P,Q28	4,5	2
Emulex, HBA: FC32, CRD,CTL,FC32,2P,LPE35002,EMX,L	4,5	2
Broadcom, NIC: 10Gb, CRD,NTWK,BCME,LP,10G,4P,BT	5,4	2
HBA: External Adapter, KIT,CRD,CTL,HBA,12GBPS-SAS	5,4	2

Tabla 5. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1A + tarjeta elevadora 2; CPU

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Tarjeta elevadora LOM; 2x1G BCM5720L	1	1
Tarjeta elevadora LOM; 2x10G BCM57416 (BASeT/SFP+)	1	1
Tarjeta elevadora de LOM; 2x25G (Broadcom)	1	1
SSD PCIe NVMe	2, 3	2
Mellanox 100G (CX5/CX6 H100)	3,2	2
Mellanox 25G (CX4LX DP/CX5 DP)	2, 3	2
Emulex (FC32 SP/DP)	3,2	2
Emulex (FC16 SP/DP)	2, 3	2
Emulex (HBA FC32 FH 1P S28)	2, 3	2

Tabla 5. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1A + tarjeta elevadora 2; CPU (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Qlogic (HBA FC32 SP/DP)	3,2	2
Qlogic (HBA FC16 SP/DP)	2, 3	2
Qlogic 10G (SFP DP)	2, 3	2
Qlogic 25G (BaseT DP)	2, 3	2
Qlogic (HBA FC32 FH 1P S28)	3,2	2
Solarflare 25G (SFP DP)	2, 3	2
Intel 10G (BaseT DP)	2, 3	2
Intel 10G (SFP+ DP)	2, 3	2
Intel 1G (QP)	2, 3	2
Intel 25G SFP DP	2, 3	2
Broadcom 1G (QP)	2, 3	2
Broadcom 10G (BaseT DP)	2, 3	2
Broadcom 25G (SFP DP)	2, 3	2
PERC 10: adaptador externo (Dell)	2, 3	1
HBA: adaptador externo (Dell)	2, 3	1
Almacenamiento interno (BOSS)	2, 3	1
PERC 9: Mini mono (H730P/H330)	Ranura integrada	1
PERC 10: Mini mono (H740P)	Ranura integrada	1
HBA: Mini mono (HBA330)	Ranura integrada	1
PERC 10: adaptador externo (H840)	2, 3	2
PERC 10: adaptador externo (H840) (FH o LP)	2, 3	2
PERC 11: adaptador externo (HBA355E)	2, 3	2
HBA: adaptador externo	2, 3	2
Intel,NIC: 100Gb, CRD,NTWK,INTL,LP,100G,2P,Q28	3,2	2
Intel NIC: 25Gb,CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28,F1	2, 3	2
Emulex, HBA: FC32, CRD,CTL,FC32,2P,LPE35002,EMX,L	3,2	2
Broadcom, NIC: 10Gb, CRD,NTWK,BCME,LP,10G,4P,BT	3,2	2
HBA: External Adapter, KIT,CRD,CTL,HBA,12GBPS-SAS	3,2	2

Tabla 6. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1B; CPU

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Tarjeta elevadora LOM; 2x1G BCM5720L	1	1
Tarjeta elevadora LOM; 2x10G BCM57416 (BASeT/SFP+)	1	1

Tabla 6. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1B; CPU (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Tarjeta elevadora de LOM; 2x25G (Broadcom)	1	1
FPGA: XILINX FH	3	1
GPU: AMD MI210 64GB 300W (FH)	3	1
GPU: Nvidia A30 24GB V2 (FH)	3	1
GPU: Nvidia A2 16GB V2 (FH)	2, 3	2
GPU: Nvidia A2 16GB V2 (LP)	5	1
GPU: Nvidia A16 64GB V2 (FH)	3	1
GPU: Nvidia V100S 32GB (FH)	3	1
GPU: Nvidia T4 16GB 70W V2 (FH)	2, 3	2
GPU: Nvidia T4 16GB 70W (LP)	5, 4	2
Intel 10G (BaseT DP FH)	2, 3	2
Intel 10G (BaseT DP LP)	5, 4	2
Intel 10G (SFP+ DP FH)	2, 3	2
Intel 10G (SFP+ DP LP)	5, 4	2
Intel 1G (QP FH)	2, 3	2
Intel 1G (QP LP)	5, 4	2
Intel 25G (SFP DP FH)	2, 3	2
Intel 25G (SFP DP LP)	5, 4	2
Broadcom 1G (QP FH)	2, 3	2
Broadcom 1G (QP LP)	5, 4	2
Broadcom 10G (BaseT DP FH)	2, 3	2
Broadcom 10G (BaseT DP LP)	5, 4	2
Broadcom 25G (SFP DP FH)	2, 3	2
Broadcom 25G (SFP DP LP)	5, 4	2
Solarflare 25G (SFP DP FH)	2, 3	2
Solarflare 25G (SFP DP LP)	5, 4	2
Mellanox 25G (CX4LX DP/CX5 DP FH)	2, 3	2
Mellanox 25G (CX4LX DP/CX5 DP LP)	5, 4	2
Qlogic 10G (SFP DP FH)	2, 3	2
Qlogic 10G (SFP DP LP)	5, 4	2
Qlogic 25G (BaseT DP FH)	2, 3	2
Qlogic 25G (BaseT DP LP)	5, 4	2
Mellanox 100G (CX5/CX6 H100, FH)	3,2	2
Mellanox 100G (CX5/CX6 H100, LP)	4, 5	2
Emulex (FC32 SP/DP, FH)	3,2	2
Emulex (FC32 SP/DP, LP)	4, 5	2
Emulex (FC16 SP/DP, FH)	2, 3	2

Tabla 6. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1B; CPU (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Emulex (FC16 SP/DP, LP)	5, 4	2
Emulex (HBA FC32 1P S28, FH)	2, 3	2
Emulex (HBA FC32 1P S28, LP)	5, 4	2
Qlogic (HBA FC32 SP/DP, FH)	3,2	2
Qlogic (HBA FC32 SP/DP, LP)	4, 5	2
Qlogic (HBA FC16 SP/DP, FH)	2, 3	2
Qlogic (HBA FC16 SP/DP, LP)	5, 4	2
Qlogic (HBA FC32 1P S28, FH)	3,2	2
Qlogic (HBA FC32 1P S28, LP)	4, 5	2
PERC 10: adaptador externo (H840, FH)	2, 3	2
PERC 11: adaptador externo (HBA355E)	2, 5, 3, 4	2
HBA: adaptador externo (FH)	2, 3	2
Almacenamiento interno (BOSS, FH)	2, 3	1
SSD PCIe NVMe (FH)	2, 3	2
SSD PCIe NVMe (LP)	5, 4	2
PERC 10: adaptador externo (H840, LP)	5, 4	2
PERC 10: adaptador externo (H840) (FH o LP)	2, 5, 3, 4	4
HBA: adaptador externo (LP)	5, 4	2
Almacenamiento interno (BOSS, LP)	5, 4	1
PERC 9: Mini mono (H730P/H330)	Ranura integrada	1
PERC 10: Mini mono (H740P)	Ranura integrada	1
HBA: Mini mono (HBA330)	Ranura integrada	1
Tarjeta elevadora de LOM (2x1G)/(2x10G)/(2x25G)	1	1
Intel, NIC: 100Gb, CRD,NTWK,INTL,FH,100G,2P,Q28	3,2	2
Intel, NIC: 100Gb, CRD,NTWK,INTL,LP,100G,2P,Q28	4,5	2
Intel, NIC: 25Gb, CRD,NTWK,INTL,FH,25G,4P,S28	3,2	2
Intel, NIC: 25Gb, CRD,NTWK,INTL,FH,25G,2P,S28	2, 3	2
Intel, NIC: 25Gb, CRD,NTWK,INTL,LP,25G,2P,S28	5, 4	2
NIC: 25Gb, Broadcom, CRD,NTWK,BCME,FH,25G,4P,S28	3,2	2
Emulex, HBA: FC32, CRD,CTL,FC32,2P,LPE35002,EMLX	3,2	2
Emulex, HBA: FC32, CRD,CTL,FC32,2P,LPE35002,EMX,L	4,5	2

Tabla 6. Configuraciones de tarjeta elevadora: tarjeta elevadora 1B; CPU (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
Broadcom, NIC: 10Gb, CRD,NTWK,BCME,FH,10G,4P,BT	2,3	2
Broadcom, NIC: 10Gb, CRD,NTWK,BCME,LP,10G,4P,BT	5,4	2
HBA: External Adapter, KIT,CRD,CTL,HBA,12GBPS-SAS	2, 5, 3, 4	4